

DOCUMENTOS



PODER EJECUTIVO
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

1

Decreto 500/011

Apruébase el Nonagésimo Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica N° 18, que incorpora la Directiva N° 07/11 de la Comisión de Comercio del MERCOSUR, relativa a "Adecuación de Requisitos Específicos de Origen".

(134*R)

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA
MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA

Montevideo, 27 de Diciembre de 2011

VISTO: el Nonagésimo Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica N° 18, suscrito el 12 de octubre de 2011 entre los Gobiernos de la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, Estados Partes del MERCOSUR, al amparo de las disposiciones establecidas en el Tratado de Montevideo de 1980;

RESULTANDO: I) que en el mismo se incorpora al Acuerdo de Complementación Económica N° 18, la Directiva N° 07/11 relativa a "Adecuación de Requisitos Específicos de Origen", aprobada por la Comisión de Comercio del MERCOSUR, el 19 de mayo de 2011;

II) que es necesario actualizar los requisitos específicos de origen del Régimen de Origen del MERCOSUR para los Bienes de Informática y Telecomunicaciones;

III) que resulta conveniente adoptar medidas transitorias con vistas a agilizar la entrada en vigor de los requisitos de origen para facilitar la operativa comercial entre los Estados Partes;

IV) que la Directiva CCM N° 07/11 tiene por objeto modificar el Apéndice I de la Decisión CMC N° 01/09, conforme consta en los Anexos I y II que forman parte de dicha Directiva;

V) que la citada protocolización fue realizada conforme a lo previsto en el artículo 4 de la Directiva CCM N° 07/11;

CONSIDERANDO: I) que de acuerdo a lo previsto en el artículo 2 del mencionado Protocolo, éste entrará en vigor 30 días después de la notificación de la Secretaría General de la ALADI a los países signatarios de que recibió la comunicación de la Secretaría del MERCOSUR, informando la incorporación de la norma MERCOSUR y de su correspondiente Protocolo Adicional a los ordenamientos jurídicos de los cuatro Estados Partes del MERCOSUR;

II) que de acuerdo a lo previsto en el artículo 3 de dicho Protocolo Adicional, una vez que éste entre en vigor, modificará el Anexo al Sexagésimo Segundo Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica N° 18 -Anexo I de la Directiva CCM

N° 10/07-, y el Anexo al Septuagésimo Séptimo Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica N° 18 -Apéndice I de la Decisión CMC N° 01/09, derogará el Octogésimo Primero y el Octogésimo Segundo Protocolos Adicionales al Acuerdo de Complementación Económica N° 18;

III) que a los efectos referidos precedentemente, corresponde incorporar al ordenamiento jurídico interno, el Nonagésimo Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica N° 18;

ATENCIÓN: a lo informado por la Delegación Permanente de la República Oriental del Uruguay ante ALADI y MERCOSUR.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Apruébase el Nonagésimo Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica N° 18, suscrito el 12 de octubre de 2011 entre los Gobiernos de la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, Estados Partes del MERCOSUR, que consta como anexo y forma parte del presente Decreto, y por el cual se incorpora al Acuerdo de Complementación Económica N° 18, al amparo de las disposiciones establecidas en el Tratado de Montevideo de 1980, la Directiva N° 07/11 de la Comisión de Comercio del MERCOSUR relativa a "Adecuación de Requisitos Específicos de Origen."

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese, publíquese y dése cuenta a la Asamblea General.

JOSÉ MUJICA, Presidente de la República; LUIS ALMAGRO; FERNANDO LORENZO; ROBERTO KRIMERMAN; DANIEL GARÍN.

ACUERDO DE COMPLEMENTACION ECONOMICA N° 18
CELEBRADO ENTRE ARGENTINA, BRASIL, PARAGUAY Y
URUGUAY

Nonagésimo Protocolo Adicional

Los Plenipotenciarios de la República Argentina, de la República Federativa del Brasil, de la República del Paraguay y de la República Oriental del Uruguay, acreditados por sus respectivos Gobiernos, según poderes otorgados en buena y debida forma, depositados oportunamente en la Secretaría General de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI),

TENIENDO EN CUENTA el Décimo Octavo Protocolo Adicional al ACE 18 y la Resolución GMC N° 43/03,

CONVIENEN:

Artículo 1° - Incorporar al Acuerdo de Complementación Económica N° 18 la Directiva N° 07/11 de la Comisión de Comercio del MERCOSUR relativa a "Adecuación de Requisitos Específicos de Origen", que consta como Anexo e integra el presente Protocolo.

Artículo 2° - El presente Protocolo entrará en vigor 30 días después de la notificación de la Secretaría General de la ALADI a los países signatarios de que recibió la comunicación de la Secretaría del MERCOSUR, informando la incorporación de la norma MERCOSUR

y de su correspondiente Protocolo Adicional a los ordenamientos jurídicos de los cuatro Estados Partes del MERCOSUR.

La Secretaría General de la ALADI deberá efectuar dicha notificación, en lo posible, el mismo día de recibida la comunicación de la Secretaría del MERCOSUR.

Artículo 3º - Una vez en vigor, el presente Protocolo modificará el Anexo al Sexagésimo Segundo Protocolo Adicional al ACE Nº 18 -Anexo I de la Directiva CCM Nº 10/07-, y el Anexo al Septuagésimo Séptimo Protocolo Adicional al ACE Nº 18 -Apéndice I de la Decisión CMC Nº 01/09; y deroga el Octogésimo Primer y el Octogésimo Segundo Protocolos Adicionales al Acuerdo de Complementación Económica Nº 18.

La Secretaría General de la ALADI será depositaria del presente Protocolo, del cual enviará copias debidamente autenticadas a los Gobiernos de los países signatarios y a la Secretaría del MERCOSUR.

EN FÉ DE LO CUAL, los respectivos Plenipotenciarios firman el presente Protocolo en la ciudad de Montevideo, a los doce días del mes de octubre del año dos mil once, en un original en los idiomas español y portugués, siendo ambos textos igualmente válidos.

Por el Gobierno de la República Argentina: Daniel Raimondi.

Por el Gobierno de la República Federativa del Brasil: Otávio Brandelli.

Por el Gobierno de la República del Paraguay: Alejandro Hamed Franco.

Por el Gobierno de la República Oriental del Uruguay: Gonzalo Rodríguez Gigena.

anteriores no entre en vigencia de acuerdo con el Artículo 40 del Protocolo de Ouro Preto, continuarán vigentes las normas anteriores que pretendan derogarse, siempre que hubieren sido incorporadas por los cuatro Estados Partes”

Que en función de ello, resulta conveniente adoptar medidas transitorias con vistas a agilizar la entrada en vigencia de los requisitos de origen para facilitar la operativa comercial entre los Estados Partes.

**LA COMISIÓN DE COMERCIO DEL MERCOSUR
APRUEBA LA SIGUIENTE DIRECTIVA:**

Art. 1 – Modificase el Apéndice I de la Decisión CMC Nº 01/09, conforme consta en los Anexos I y II que forman parte de la presente Directiva.

Art. 2 - Hasta tanto la Decisión CMC Nº 01/09 entre en vigencia, las modificaciones establecidas en el Artículo 1º se aplicarán al Anexo I de la Directiva CCM Nº 10/07, donde corresponda.

Art. 3 - Deróganse las Directivas CCM Nº 21/09 y Nº 22/09.

Art. 4 – Solicitase a los Estados Partes que instruyan a sus respectivas Representaciones ante la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), a protocolizar la presente Directiva en el marco del Acuerdo de Complementación Económica Nº 18, en los términos establecidos en la Resolución GMC Nº 43/03.

Art. 5 – Esta Directiva deberá ser incorporada al ordenamiento jurídico de los Estados Partes antes del 31/X/2011.

CXX CCM – Montevideo, 19/V/11

ANEXO I

a) Incorporar al listado:

ANEXO

**SECRETARÍA DEL MERCOSUR
RESOLUCIÓN GMC Nº 26/01 – ARTÍCULO 10
FE DE ERRATAS - ORIGINAL – 11/08/11**

**Agustín Colombo Sierra
Director**

MERCOSUR/CCM/DIR Nº 07/11

ADECUACION DE REQUISITOS ESPECIFICOS DE ORIGEN

VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto, las Decisiones Nº 08/03 y 01/09 del Consejo del Mercado Común, las Resoluciones Nº 29/10, 30/10 y 47/10 del Grupo Mercado Común y las Directivas Nº 10/07, 21/09 y 22/09 de la Comisión de Comercio del MERCOSUR.

CONSIDERANDO:

Que el Régimen de Origen MERCOSUR faculta a la Comisión de Comercio del MERCOSUR a modificar dicho Régimen por medio de Directivas.

Que es necesario adecuar los requisitos específicos de origen del Régimen de Origen del MERCOSUR a las modificaciones en la Nomenclatura Común del MERCOSUR.

Que es necesario actualizar los requisitos específicos de origen del Régimen de Origen del MERCOSUR para los Bienes de Informática y Telecomunicaciones.

Que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 2 de la Decisión CMC Nº 08/03, “mientras una norma que derogue una o más normas

NCM2007	REQUISITO DE ORIGEN
2102.10.10	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
2102.10.90	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
5603.11.20	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
5603.11.30	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
5603.11.40	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
5603.12.30	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
5603.12.40	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
5603.12.50	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
5603.13.30	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
5603.13.40	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
5603.13.50	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
5603.14.20	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
5603.14.30	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
5603.14.40	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
5603.91.10	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
5603.91.20	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
5603.91.30	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
5603.91.90	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
5603.92.20	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
5603.92.30	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
5603.92.40	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
5603.93.20	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
5603.93.30	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
5603.93.40	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
5603.94.10	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
5603.94.20	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
5603.94.30	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional

5603.94.90	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
7304.51.11	Deberán ser producidos a partir de productos incluidos en la posición 7206 ó 7207 ó 7218 ó 7224, fundidos y moldeados o colados en los Estados Partes.
7304.51.19	Deberán ser producidos a partir de productos incluidos en la posición 7206 ó 7207 ó 7218 ó 7224, fundidos y moldeados o colados en los Estados Partes.
9006.10.10	60% de valor agregado regional.
9006.10.90	60% de valor agregado regional.

b) Eliminar del listado:

NCM2007	REQUISITO DE ORIGEN
2102.10.00	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
5603.91.00	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
5603.94.00	Salto de partida arancelaria más 60% de valor agregado regional
7304.51.10	Deberán ser producidos a partir de productos incluidos en la posición 7206 ó 7207 ó 7218 ó 7224, fundidos y moldeados o colados en los Estados Partes..
9006.10.00	60% de valor agregado regional.

ANEXO II

a) Sustituir del listado:

NCM 2007	DONDE DICE:	DEBE DECIR:
	REQUISITO DE ORIGEN	REQUISITO DE ORIGEN
8443.32.21	Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8443.32.22	Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8443.32.23	Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.

<p>8443.32.29</p>	<p>Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.</p>	<p>I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.</p>
<p>8443.32.35</p>	<p>Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.</p>	<p>I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.</p>
<p>8443.32.39</p>	<p>Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.</p>	<p>I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.</p>
<p>8443.32.51</p>	<p>Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.</p>	<p>I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.</p>

8443.32.59	<p>Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.</p>	<p>I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.</p>
8470.50.11	<p>Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.</p>	<p>I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.</p>
8470.50.19	<p>Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.</p>	<p>I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.</p>
8471.30.12	<p>MICROCOMPUTADORAS PORTÁTILES: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso que implementen las funciones de procesamiento y memoria, las controladoras de periféricos para teclado, y unidades de discos magnéticos y las interfaces de comunicación en serie y paralela acumulativamente. Cuando las unidades centrales de procesamiento incorporen en el mismo cuerpo o gabinete, placas de circuito impreso que implementen las funciones de red local o emulación de terminal, estas placas también deberán tener el montaje y soldadura de todos sus componentes; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Pantalla ("display") de los ítem 8473.30.91 y 8473.30.92; y 2) Teclado del ítem 8471.60.52. No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.</p>	<p>I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.</p>

<p>8471.30.19</p>	<p>MICROCOMPUTADORAS PORTÁTILES: Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso que implementen las funciones de procesamiento y memoria, las controladoras de periféricos para teclado, y unidades de discos magnéticos y las interfases de comunicación en serie y paralela acumulativamente. Cuando las unidades centrales de procesamiento incorporen en el mismo cuerpo o gabinete, placas de circuito impreso que implementen las funciones de red local o emulación de terminal, estas placas también deberán tener el montaje y soldadura de todos sus componentes; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Pantalla ("display") de los ítem 8473.30.91 y 8473.30.92; y 2) Teclado del ítem 8471.60.52. No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuente de alimentación.-</p>	<p>I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.</p>
<p>8471.30.90</p>	<p>Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B. No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.</p>	<p>I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.</p>
<p>8471.41.90</p>	<p>Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B. No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.</p>	<p>I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.</p>
<p>8471.50.10</p>	<p>UNIDADES DIGITALES DE PROCESAMIENTO DE PEQUEÑA CAPACIDAD. Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso que implementan las funciones de procesamiento y memoria y las siguientes interfases: en serie, paralela, de unidades de discos magnéticos, de teclado y de video, acumulativamente. Cuando las unidades centrales de procesamiento incorporen en el mismo cuerpo o gabinete placas de circuito impreso que implementen las funciones de red local o emulación de terminal, estas placas también deberán tener un montaje y soldadura de todos los componentes. B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" e "B" anteriores. No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación. En las unidades digitales de procesamiento del tipo "disless", destinadas a interconexión en redes locales, el montaje de la placa que implementa la interfase de red local podrá sustituir el montaje de las placas que implementan las interfases en serie, paralela y de unidades de discos magnéticos;</p>	<p>I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.</p>

8471.50.20	<p>UNIDADES DIGITALES DE CAPACIDAD MEDIANA Y GRANDE. Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en el conjunto de placas de circuito impreso que implementen como mínimo 3 (tres) de las 5 (cinco) siguientes funciones: a) procesamiento central; b) memoria; c) unidad de control integrada/ interfase o controladoras de periféricos; d) soporte y diagnóstico de sistema; e) canal o interfase de comunicación con unidad de entrada y salida de datos y periféricos; o, alternativamente, el montaje de por lo menos 4 (cuatro) placas de circuito impreso que implementen cualquiera de estas funciones; B. Montaje e integración de las placas de circuito impreso y de los conjuntos eléctricos y mecánicos en la formación del producto final; y C. Cuando el montaje del producto se realice con conjuntos en forma de cajón, estos conjuntos deberán ser montados a partir de sus subconjuntos, tales como: fuentes de alimentación, placas de circuito impreso y cables. Cuando la empresa opte por el montaje del número de placas de circuito impreso, establecido en el ítem "A", en caso de que se utilice placas que sean padrones del mercado, como por ejemplo, placas de memoria del tipo "SIMM" del ítem 8473.30.42 o 8473.50.50, se considerará una placa por función, independientemente de la cantidad de placas montadas para implementar la función. Para cumplir con lo dispuesto se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A", "B" y "C". Lo dispuesto en este Régimen, también se aplica a las unidades de control de periféricos, tales como controladores de discos, cintas, impresoras y lectoras ópticas y/o magnéticas y las expansiones de las funciones mencionadas en el ítem "A", incluso cuando no se presenten en el mismo cuerpo o gabinete de las unidades digitales de procesamiento.</p>	<p>I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.</p>
8471.50.30	<p>UNIDADES DIGITALES DE CAPACIDAD MEDIANA Y GRANDE. Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en el conjunto de placas de circuito impreso que implementen como mínimo 3 (tres) de las 5 (cinco) siguientes funciones: a) procesamiento central; b) memoria; c) unidad de control integrada/ interfase o controladoras de periféricos; d) soporte y diagnóstico de sistema; e) canal o interfase de comunicación con unidad de entrada y salida de datos y periféricos; o, alternativamente, el montaje de por lo menos 4 (cuatro) placas de circuito impreso que implementen cualquiera de estas funciones; B. Montaje e integración de las placas de circuito impreso y de los conjuntos eléctricos y mecánicos en la formación del producto final; y C. Cuando el montaje del producto se realice con conjuntos en forma de cajón, estos conjuntos deberán ser montados a partir de sus subconjuntos, tales como: fuentes de alimentación, placas de circuito impreso y cables. Cuando la empresa opte por el montaje del número de placas de circuito impreso, establecido en el ítem "A", en caso de que se utilice placas que sean padrones del mercado, como por ejemplo, placas de memoria del tipo "SIMM" del ítem 8473.30.42 o 8473.50.50, se considerará una placa por función, independientemente de la cantidad de placas montadas para implementar la función. Para cumplir con lo dispuesto se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A", "B" y "C". Lo dispuesto en este Régimen, también se aplica a las unidades de control de periféricos, tales como controladores de discos, cintas, impresoras y lectoras ópticas y/o magnéticas y las expansiones de las funciones mencionadas en el ítem "A", incluso cuando no se presenten en el mismo cuerpo o gabinete de las unidades digitales de procesamiento.</p>	<p>I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.</p>
8471.50.40	<p>UNIDADES DIGITALES DE CAPACIDAD MUY GRANDE. Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en el conjunto de placas de circuito impreso que implementen por lo menos 2 (dos) de las 5 (cinco) siguientes funciones: a) procesamiento central; b) memoria c) unidad de control integrada/interfase; d) soporte y diagnóstico de sistemas; e) canal de comunicación, o alternativamente, el montaje de por lo menos 3 (tres) placas de circuito impreso que implementen cualquiera de estas funciones; B. Montaje e integración de las placas de circuito impreso y de los conjuntos eléctricos y mecánicos en la formación del producto final; y C. Cuando el montaje del producto se realice con conjuntos en forma de cajón, estos conjuntos deberán ser montados a partir de sus subconjuntos, tales como: fuentes de alimentación, placas de circuito impreso y cables. Cuando la empresa opte por el montaje del número de placas de circuito impreso establecido en el ítem "A", en caso de que se utilice placas que sean padrones de mercado, como por ejemplo, placas de memoria del tipo "SIMM", de los ítem 8473.30.42 o 8473.50.50, se considerará una placa por función, independientemente de la cantidad de placas montadas para implementar la función. Para cumplir con lo dispuesto se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A", "B" y "C". Lo dispuesto en este Régimen también se aplica a las unidades de control de periférico, tales como controladoras de discos, cintas, impresoras y lectoras ópticas y/o magnéticas y a las expansiones de las funciones mencionadas en el ítem "A", incluso cuando no se presenten en el mismo cuerpo o gabinete de las unidades digitales de procesamiento.</p>	<p>I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.</p>

<p>8471.50.90</p>	<p>Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.</p>	<p>I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.</p>
<p>8471.60.52</p>	<p>Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.</p>	<p>I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.</p>
<p>8471.60.53</p>	<p>Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.</p>	<p>I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.</p>
<p>8471.60.59</p>	<p>Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.</p>	<p>I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.</p>

8471.60.61	<p>Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.</p>	<p>I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.</p>
8471.60.62	<p>Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.</p>	<p>I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.</p>
8471.60.80	<p>Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.</p>	<p>I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.</p>
8471.60.90	<p>Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.</p>	<p>I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.</p>

<p>8471.70.12</p>	<p>DISCOS DUROS. Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B"; D. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B", y E. Para la producción de discos magnéticos duros con capacidad de almacenaje superior a 1 (un) GBYTES por HDA (Head Disk Assembly) no formateado, podrá optarse entre cumplir con lo dispuesto en los ítem "A" o "B" y en caso de cumplirse con lo dispuesto en el ítem "A" deberán ser soldados y montados todos los componentes en las placas de circuito impreso que implementen por lo menos dos de las siguientes funciones: a) comunicación con la unidad controladora de disco; b) posicionamiento de los conjuntos de lectura y grabación; c) o lectura y grabación.</p>	<p>I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.</p>
<p>8471.70.19</p>	<p>DISCOS DUROS. Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B"; D. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B", y E. Para la producción de discos magnéticos duros con capacidad de almacenaje superior a 1 (un) GBYTES por HDA (Head Disk Assembly) no formateado, podrá optarse entre cumplir con lo dispuesto en los ítem "A" o "B" y en caso de cumplirse con lo dispuesto en el ítem "A" deberán ser soldados y montados todos los componentes en las placas de circuito impreso que implementen por lo menos dos de las siguientes funciones: a) comunicación con la unidad controladora de disco; b) posicionamiento de los conjuntos de lectura y grabación; c) o lectura y grabación.</p>	<p>I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.</p>
<p>8471.70.39</p>	<p>Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.</p>	<p>I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.</p>
<p>8471.70.90</p>	<p>Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.</p>	<p>I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.</p>

8471.80.00	<p>Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.</p>	<p>I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.</p>
8471.90.11	<p>Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.</p>	<p>I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.</p>
8471.90.12	<p>Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.</p>	<p>I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.</p>
8471.90.13	<p>Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.</p>	<p>I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.</p>

<p>8471.90.19</p>	<p>Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.</p>	<p>I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.</p>
<p>8471.90.90</p>	<p>Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.</p>	<p>I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.</p>
<p>8472.90.10</p>	<p>Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.</p>	<p>I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.</p>
<p>8472.90.21</p>	<p>Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.</p>	<p>I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.</p>

8472.90.29	Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8472.90.59	Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8473.29.10	CIRCUITOS IMPRESOS MONTADOS CON COMPONENTES ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS. Montaje y soldadura en las placas de circuito impreso de todos los componentes, siempre que estos no partan de la subpartida 8473.30.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso; II- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8473.30.41	CIRCUITOS IMPRESOS MONTADOS CON COMPONENTES ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS. Montaje y soldadura en las placas de circuito impreso de todos los componentes, siempre que estos no partan de la subpartida 8473.30.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso; II- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8473.30.42	PLACAS (MÓDULOS DE MEMORIA) CON UNA SUPERFICIE INFERIOR O IGUAL A 50 CM2. Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje de la pastilla semiconductor no encapsulada; B. Encapsulamiento de la pastilla; C. Test (ensayo) eléctrico; D. Marcación (identificación) del componente (memoria); y E. Montaje y soldadura de los componentes semiconductores (memoria) en el circuito impreso.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso; II- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8473.30.49	CIRCUITOS IMPRESOS MONTADOS CON COMPONENTES ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS. Montaje y soldadura en las placas de circuito impreso de todos los componentes, siempre que estos no partan de la subpartida 8473.30.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso; II- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8473.40.10	CIRCUITOS IMPRESOS MONTADOS CON COMPONENTES ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS. Montaje y soldadura en las placas de circuito impreso de todos los componentes, siempre que estos no partan de la subpartida 8473.30.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso; II- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8473.50.10	CIRCUITOS IMPRESOS MONTADOS CON COMPONENTES ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS. Montaje y soldadura en las placas de circuito impreso de todos los componentes, siempre que estos no partan de la subpartida 8473.30.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso; II- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8473.50.50	PLACAS (MÓDULOS DE MEMORIA) CON UNA SUPERFICIE INFERIOR O IGUAL A 50 CM2. Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje de la pastilla semiconductor no encapsulada; B. Encapsulamiento de la pastilla; C. Test (ensayo) eléctrico; D. Marcación (identificación) del componente (memoria); y E. Montaje y soldadura de los componentes semiconductores (memoria) en el circuito impreso.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso; II- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.

8511.80.30	<p>Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.</p>	<p>I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.</p>
8517.12.11	<p>Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.</p>	<p>I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.</p>
8517.12.12	<p>Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.</p>	<p>I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.</p>
8517.12.13	<p>Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.</p>	<p>I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.</p>
8517.12.19	<p>Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.</p>	<p>I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.</p>
8517.12.21	<p>Cumplir con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.</p>	<p>I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.</p>
8517.12.22	<p>Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.</p>	<p>I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.</p>
8517.12.23	<p>Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.</p>	<p>I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.</p>

8517.62.65	Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8517.62.71	Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8517.62.72	Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8517.62.79	Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8517.62.91	Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8517.62.93	Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8517.62.94	Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8517.62.95	Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.

8517.62.96	Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8517.70.10	CIRCUITOS IMPRESOS MONTADOS CON COMPONENTES ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS. Montaje y soldadura en las placas de circuito impreso de todos los componentes, siempre que estos no partan de la subpartida 8473.30.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso; II- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8523.52.00	COMPONENTES SEMICONDUCTORES Y DISPOSITIVOS OPTOELECTRÓNICOS. Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje de la pastilla semiconductor no encapsulada; B. Encapsulamiento de la pastilla montada; C. Test (ensayo) eléctrico u optoelectrónico; D. Marcación (identificación); E. Los circuitos integrados bipolares con tecnología superior a cinco micrones (micra) y los diodos de potencia deberán también realizar el procesamiento físico-químico de la pastilla semiconductor; y F. Los circuitos integrados monolíticos proyectados en alguno de los Estados Partes están exentos de realizar las etapas "A" y "B" anteriores.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso; II- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8523.59.10	Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso; II- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8525.50.19	Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8525.50.29	Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8525.60.10	Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8525.60.90	Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.

8528.51.10	<p>Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.</p>	<p>I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.</p>
8528.51.20	<p>Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.</p>	<p>I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.</p>
8528.61.00	<p>Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.</p>	<p>I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.</p>
8529.90.12	<p>CIRCUITOS IMPRESOS MONTADOS CON COMPONENTES ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS. Montaje y soldadura en las placas de circuito impreso de todos los componentes, siempre que estos no partan de la subpartida 8473.30.</p>	<p>I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso; II- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.</p>
8531.20.00	<p>Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.</p>	<p>I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.</p>

8537.10.11	<p>Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.</p>	<p>I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.</p>
8537.10.19	<p>Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.</p>	<p>I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.</p>
8537.10.20	<p>Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.</p>	<p>I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.</p>
8543.70.12	<p>Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.</p>	<p>I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.</p>
8543.70.14	<p>Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.</p>	<p>I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.</p>
8543.70.15	<p>Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.</p>	<p>I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.</p>

8543.70.19	Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8543.70.39	Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8543.70.91	Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
9030.33.11	Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
9030.33.19	Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
9030.39.10	Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.

<p>9030.40.10</p>	<p>Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.</p>	<p>I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.</p>
<p>9030.40.20</p>	<p>Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.</p>	<p>I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.</p>
<p>9030.40.30</p>	<p>Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.</p>	<p>I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.</p>
<p>9030.40.90</p>	<p>Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.</p>	<p>I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.</p>

9030.82.10	<p>Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.</p>	<p>I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.</p>
9030.82.90	<p>Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.</p>	<p>I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.</p>
9030.89.40	<p>Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.</p>	<p>I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.</p>
9030.89.90	<p>Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.</p>	<p>I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.</p>

<p>9030.90.90</p>	<p>Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.</p>	<p>I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.</p>
<p>9031.80.40</p>	<p>Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.</p>	<p>I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.</p>
<p>9032.89.11</p>	<p>Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.</p>	<p>I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.</p>
<p>9032.89.21</p>	<p>Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.</p>	<p>I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.</p>

9032.89.22	<p>Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.</p>	<p>I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.</p>
9032.89.23	<p>Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.</p>	<p>I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.</p>
9032.89.24	<p>Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.</p>	<p>I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.</p>
9032.89.25	<p>Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.</p>	<p>I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.</p>

<p>9032.89.29</p>	<p>Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.</p>	<p>I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.</p>
<p>9032.89.81</p>	<p>Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.</p>	<p>I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.</p>
<p>9032.89.82</p>	<p>Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.</p>	<p>I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.</p>
<p>9032.89.83</p>	<p>Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.</p>	<p>I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.</p>

9032.89.89	Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
9032.90.10	CIRCUITOS IMPRESOS MONTADOS CON COMPONENTES ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS. Montaje y soldadura en las placas de circuito impreso de todos los componentes, siempre que estos no partan de la subpartida 8473.30.	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso; II- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.

b) incorporar al listado:

NCM 2007	REQUISITO DE ORIGEN
8443.31.11	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8443.31.12	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8443.31.13	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8443.31.14	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8443.31.15	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8443.31.16	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8443.31.19	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8443.31.91	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8443.31.99	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8443.32.31	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8443.32.32	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.

8517.62.78	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8517.62.92	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8517.69.00	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8528.71.11	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso que implemente la función de procesamiento central (placa principal); II- Integración de la placa de circuito impreso montada conforme al ítem I, de las demás placas de circuito impreso (si las hubiera) y de las demás partes eléctricas, mecánicas y de los subconjuntos en la formación del producto final; y III- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.
8538.90.10	I- Montaje y soldadura de todos los componentes en la placa de circuito impreso; II- Configuración final del producto, instalación del software (cuando fuera el caso) y pruebas de funcionamiento.

c) eliminar del listado:

NCM 2007	REQUISITO DE ORIGEN
8443.31.00	60% de valor agregado regional.
8443.32.11	Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.
8443.32.12	Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.
8443.32.13	Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.
8443.32.19	Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.
8443.99.11	CIRCUITOS IMPRESOS MONTADOS CON COMPONENTES ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS. Montaje y soldadura en las placas de circuito impreso de todos los componentes, siempre que estos no partan de la subpartida 8473.30.
8443.99.13	Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.

8473.30.99	Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.
8473.50.32	Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.
8473.50.39	Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.
8473.50.90	Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.
8517.70.92	Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.
8517.70.99	Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.
8518.10.10	Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.
8518.29.10	Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.
8528.41.10	Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.

8528.41.20	Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.
8529.90.19	Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.
8540.50.20	Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimilar" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.
8541.10.22	COMPONENTES SEMICONDUCTORES Y DISPOSITIVOS OPTOELECTRÓNICOS. Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje de la pastilla semiconductor no encapsulada; B. Encapsulamiento de la pastilla montada; C. Test (ensayo) eléctrico u optoelectrónico; D. Marcación (identificación); E. Los circuitos integrados bipolares con tecnología superior a cinco micrones (micra) y los diodos de potencia deberán también realizar el procesamiento físico-químico de la pastilla semiconductor; y F. Los circuitos integrados monolíticos proyectados en alguno de los Estados Partes están exentos de realizar las etapas "A" y "B" anteriores.
8541.10.29	COMPONENTES SEMICONDUCTORES Y DISPOSITIVOS OPTOELECTRÓNICOS. Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje de la pastilla semiconductor no encapsulada; B. Encapsulamiento de la pastilla montada; C. Test (ensayo) eléctrico u optoelectrónico; D. Marcación (identificación); E. Los circuitos integrados bipolares con tecnología superior a cinco micrones (micra) y los diodos de potencia deberán también realizar el procesamiento físico-químico de la pastilla semiconductor; y F. Los circuitos integrados monolíticos proyectados en alguno de los Estados Partes están exentos de realizar las etapas "A" y "B" anteriores.
8541.10.92	COMPONENTES SEMICONDUCTORES Y DISPOSITIVOS OPTOELECTRÓNICOS. Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje de la pastilla semiconductor no encapsulada; B. Encapsulamiento de la pastilla montada; C. Test (ensayo) eléctrico u optoelectrónico; D. Marcación (identificación); E. Los circuitos integrados bipolares con tecnología superior a cinco micrones (micra) y los diodos de potencia deberán también realizar el procesamiento físico-químico de la pastilla semiconductor; y F. Los circuitos integrados monolíticos proyectados en alguno de los Estados Partes están exentos de realizar las etapas "A" y "B" anteriores.
8541.10.99	COMPONENTES SEMICONDUCTORES Y DISPOSITIVOS OPTOELECTRÓNICOS. Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje de la pastilla semiconductor no encapsulada; B. Encapsulamiento de la pastilla montada; C. Test (ensayo) eléctrico u optoelectrónico; D. Marcación (identificación); E. Los circuitos integrados bipolares con tecnología superior a cinco micrones (micra) y los diodos de potencia deberán también realizar el procesamiento físico-químico de la pastilla semiconductor; y F. Los circuitos integrados monolíticos proyectados en alguno de los Estados Partes están exentos de realizar las etapas "A" y "B" anteriores.
8541.29.20	COMPONENTES SEMICONDUCTORES Y DISPOSITIVOS OPTOELECTRÓNICOS. Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje de la pastilla semiconductor no encapsulada; B. Encapsulamiento de la pastilla montada; C. Test (ensayo) eléctrico u optoelectrónico; D. Marcación (identificación); E. Los circuitos integrados bipolares con tecnología superior a cinco micrones (micra) y los diodos de potencia deberán también realizar el procesamiento físico-químico de la pastilla semiconductor; y F. Los circuitos integrados monolíticos proyectados en alguno de los Estados Partes están exentos de realizar las etapas "A" y "B" anteriores.
8541.30.21	COMPONENTES SEMICONDUCTORES Y DISPOSITIVOS OPTOELECTRÓNICOS. Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje de la pastilla semiconductor no encapsulada; B. Encapsulamiento de la pastilla montada; C. Test (ensayo) eléctrico u optoelectrónico; D. Marcación (identificación); E. Los circuitos integrados bipolares con tecnología superior a cinco micrones (micra) y los diodos de potencia deberán también realizar el procesamiento físico-químico de la pastilla semiconductor; y F. Los circuitos integrados monolíticos proyectados en alguno de los Estados Partes están exentos de realizar las etapas "A" y "B" anteriores.

8542.39.99	COMPONENTES SEMICONDUCTORES Y DISPOSITIVOS OPTOELECTRÓNICOS. Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje de la pastilla semiconductor a no encapsulada; B. Encapsulamiento de la pastilla montada; C. Test (ensayo) eléctrico u optoelectrónico; D. Marcación (identificación); E. Los circuitos integrados bipolares con tecnología superior a cinco micrones (micra) y los diodos de potencia deberán también realizar el procesamiento físico-químico de la pastilla semiconductor; y F. Los circuitos integrados monolíticos proyectados en alguno de los Estados Partes están exentos de realizar las etapas "A" y "B" anteriores.
8543.70.92	Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.
8543.70.99	Cambio de partida y que cumpla con el siguiente proceso productivo: A - Montaje como mínimo del 80% de las placas de circuito impreso por producto; B - Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; C - Montaje de las partes eléctricas y mecánicas totalmente desagregadas a nivel básico de componentes; y D - Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final.
8544.70.10	CABLES ÓPTICOS. Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Pintura de fibras; B. Reunión de fibras en grupos; C. Reunión para formación de núcleos; D. Extrusión de la capa o aplicación de armazón metálica y marcación; E. Se admitirá la realización de las actividades descritas en los ítem "A" y "B" por terceros, siempre que se efectúe en uno de los Estados Partes; F. Las empresas deberán realizar actividades de ingeniería referentes al desarrollo y adaptación del producto a su fabricación y test (ensayos) de aceptación operativa; y G. Los cables ópticos deberán utilizar fibras ópticas que atiendan el requisito específico de origen definido para las mismas.
8544.70.30	CABLES ÓPTICOS. Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Pintura de fibras; B. Reunión de fibras en grupos; C. Reunión para formación de núcleos; D. Extrusión de la capa o aplicación de armazón metálica y marcación; E. Se admitirá la realización de las actividades descritas en los ítem "A" y "B" por terceros, siempre que se efectúe en uno de los Estados Partes; F. Las empresas deberán realizar actividades de ingeniería referentes al desarrollo y adaptación del producto a su fabricación y test (ensayos) de aceptación operativa; y G. Los cables ópticos deberán utilizar fibras ópticas que atiendan el requisito específico de origen definido para las mismas.
8544.70.90	CABLES ÓPTICOS. Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Pintura de fibras; B. Reunión de fibras en grupos; C. Reunión para formación de núcleos; D. Extrusión de la capa o aplicación de armazón metálica y marcación; E. Se admitirá la realización de las actividades descritas en los ítem "A" y "B" por terceros, siempre que se efectúe en uno de los Estados Partes; F. Las empresas deberán realizar actividades de ingeniería referentes al desarrollo y adaptación del producto a su fabricación y test (ensayos) de aceptación operativa; y G. Los cables ópticos deberán utilizar fibras ópticas que atiendan el requisito específico de origen definido para las mismas.
9001.10.11	FIBRAS ÓPTICAS. Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Procesamiento físico-químico que resulte en la obtención de la preforma; B. Estiramiento de la fibra; C. Test; D. Embalaje; E. Se admitirá la realización de la actividad descrita en el ítem "A" por terceros, siempre que se efectúe en uno de los Estados Partes; y F. Las empresas deberán realizar actividades de ingeniería referentes al desarrollo y adaptación del producto a su fabricación y test (ensayos).
9001.10.19	FIBRAS ÓPTICAS. Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Procesamiento físico-químico que resulte en la obtención de la preforma; B. Estiramiento de la fibra; C. Test; D. Embalaje; E. Se admitirá la realización de la actividad descrita en el ítem "A" por terceros, siempre que se efectúe en uno de los Estados Partes; y F. Las empresas deberán realizar actividades de ingeniería referentes al desarrollo y adaptación del producto a su fabricación y test (ensayos).
9001.10.20	CABLES ÓPTICOS. Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Pintura de fibras; B. Reunión de fibras en grupos; C. Reunión para formación de núcleos; D. Extrusión de la capa o aplicación de armazón metálica y marcación; E. Se admitirá la realización de las actividades descritas en los ítem "A" y "B" por terceros, siempre que se efectúe en uno de los Estados Partes; F. Las empresas deberán realizar actividades de ingeniería referentes al desarrollo y adaptación del producto a su fabricación y test (ensayos) de aceptación operativa; y G. Los cables ópticos deberán utilizar fibras ópticas que atiendan el requisito específico de origen definido para las mismas.
9026.10.11	Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.
9028.30.11	Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.
9028.30.21	Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.

9028.30.31

Cumplir con el siguiente proceso productivo: A. Montaje y soldadura de todos los componentes en las placas de circuito impreso; B. Montaje de las partes eléctricas y mecánicas, totalmente desagregadas, a nivel básico de componentes; y C. Integración de las placas de circuito impreso y de las partes eléctricas y mecánicas en la formación del producto final de acuerdo con los ítem "A" y "B" anteriores. Están exentos del montaje los siguientes módulos o subconjuntos: 1) Mecanismos del ítem 8473.30.22 para impresoras de las subpartidas 8471.49.3 y 8471.60.2; 2) Mecanismos del ítem 8517.90.91 para aparatos de "facsimil" de los ítem 8517.21.10 y 8517.21.20; y 3) Banco de martillos de los subítem 8473.30.23 y 8473.50.31 para impresoras de línea de los ítem 8471.49.21 y 8471.60.11. Se admitirá la utilización de subconjuntos montados en los Estados Partes por terceros, siempre que la producción de los mismos atienda lo establecido en los ítem "A" y "B". No desnaturaliza el cumplimiento del régimen de origen definido, la inclusión en un mismo cuerpo o gabinete de unidades de discos magnéticos, ópticos y fuentes de alimentación.

2

Decreto 501/011

Apruébase el Nonagésimo Primer Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica Nº 18, que incorpora la Directiva Nº 05/11 de la Comisión de Comercio del MERCOSUR, relativa a "Regímenes Especiales de Importación".

(135*R)

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA
MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA

Montevideo, 27 de Diciembre de 2011

VISTO: el Nonagésimo Primer Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica Nº 18, suscrito el 12 de octubre de 2011 entre los Gobiernos de la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, Estados Partes del MERCOSUR, al amparo de las disposiciones establecidas en el Tratado de Montevideo de 1980;

RESULTANDO: I) que en el mismo se incorpora al Acuerdo de Complementación Económica Nº 18, la Directiva Nº 05/11 relativa a "Regímenes Especiales de Importación", aprobada por la Comisión de Comercio del MERCOSUR, el 03 de marzo de 2011;

II) que la Directiva CCM Nº 05/11 tiene por objeto adoptar para los Regímenes Especiales de Importación comprendidos en el Anexo de la Decisión CMC Nº 03/06, incluyendo los incorporados por las Directivas CCM Nº 12/06 y 31/09, la clasificación que consta en Anexo y forma parte de dicha Directiva;

III) que la citada protocolización fue realizada conforme a lo previsto en el artículo 4 de la Directiva CCM Nº 05/11;

CONSIDERANDO: I) que de acuerdo a lo previsto en el artículo 2 del mencionado Protocolo, éste entrará en vigor 30 días después de la notificación de la Secretaría General de la ALADI a los países signatarios de que recibió la comunicación de la Secretaría del MERCOSUR, informando la incorporación de la norma MERCOSUR y de su correspondiente Protocolo Adicional a los ordenamientos jurídicos de los cuatro Estados Partes del MERCOSUR;

II) que a los efectos referidos precedentemente, corresponde incorporar al ordenamiento jurídico interno, el Nonagésimo Primer Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica Nº 18;

ATENTO: a lo informado por la Delegación Permanente de la República Oriental del Uruguay ante ALADI y MERCOSUR.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- Apruébase el Nonagésimo Primer Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica Nº 18, suscrito el 12 de octubre de 2011 entre los Gobiernos de la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, Estados Partes del MERCOSUR, que consta como anexo y forma parte del presente Decreto, y por el cual se incorpora al Acuerdo de Complementación Económica Nº 18, al amparo de las disposiciones establecidas en el Tratado de Montevideo de 1980, la Directiva Nº 05/11 de la Comisión de Comercio del MERCOSUR relativa a "Regímenes Especiales de Importación."

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese y dése cuenta a la Asamblea General.

JOSÉ MUJICA, Presidente de la República; LUIS ALMAGRO; FERNANDO LORENZO; ROBERTO KREIMERMAN; DANIEL GARÍN.

**ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA Nº 18
CELEBRADO ENTRE ARGENTINA, BRASIL, PARAGUAY Y
URUGUAY**

Nonagésimo Primer Protocolo Adicional

Los Plenipotenciarios de la República Argentina, de la República Federativa del Brasil, de la República del Paraguay y de la República Oriental del Uruguay, acreditados por sus respectivos Gobiernos, según poderes otorgados en buena y debida forma, depositados oportunamente en la Secretaría General de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI),

TENIENDO EN CUENTA el Décimo Octavo Protocolo Adicional al ACE 18 y la Resolución GMC Nº 43/03,

CONVIENEN:

Artículo 1º - Incorporar al Acuerdo de Complementación Económica Nº 18 la Directiva Nº 05/11 de la Comisión de Comercio del MERCOSUR relativa a "Regímenes Especiales de Importación", que consta como Anexo e integra el presente Protocolo.

Artículo 2º - El presente Protocolo entrará en vigor 30 días después de la notificación de la Secretaría General de la ALADI a los países signatarios de que recibió la comunicación de la Secretaría del MERCOSUR, informando la incorporación de la norma MERCOSUR y de su correspondiente Protocolo Adicional a los ordenamientos jurídicos de los cuatro Estados Partes del MERCOSUR.

La Secretaría General de la ALADI deberá efectuar dicha notificación, en lo posible, el mismo día de recibida la comunicación de la Secretaría del MERCOSUR.

La Secretaría General de la ALADI será depositaria del presente Protocolo, del cual enviará copias debidamente autenticadas a los Gobiernos de los países signatarios y a la Secretaría del MERCOSUR.

EN FÉ DE LO CUAL, los respectivos Plenipotenciarios firman el presente Protocolo en la ciudad de Montevideo, a los doce días del mes de octubre del año dos mil once, en un original en los idiomas español y portugués, siendo ambos textos igualmente válidos.

Por el Gobierno de la República Argentina: Daniel Raimondi.

Por el Gobierno de la República Federativa del Brasil: Otávio Brandelli.

Por el Gobierno de la República del Paraguay: Alejandro Hamed Franco.

Por el Gobierno de la República Oriental del Uruguay: Gonzalo Rodríguez Gigena.

ANEXO

MERCOSUR/CMC/DIR. N° 05/11

REGÍMENES ESPECIALES DE IMPORTACIÓN

VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto, las Decisiones N° 69/00, 33/05, 03/06, 14/07 y 57/08 del Consejo del Mercado Común y las Directivas N° 12/06 y 31/09 de la Comisión de Comercio del Mercosur.

CONSIDERANDO:

Que el artículo 4° de Decisión CMC N° 33/05 encomendó la elaboración de una lista que contenga los regímenes nacionales de importación que podrán permanecer vigentes por razones tales como su impacto económico limitado o su finalidad no comercial.

Que en el Anexo de la Decisión CMC N° 03/06 se listaron los Regímenes Especiales de Importación adoptados unilateralmente por los Estados Partes del MERCOSUR con anterioridad al 30 de junio de 2000 y que cumplen con las condiciones establecidas en el artículo 4° de la Decisión CMC N° 33/05.

Que el artículo 6° de la Decisión CMC N° 03/06 determinó que los Estados Partes deberán informar a la CCM, en la segunda reunión del año los datos de comercio de las importaciones (discriminando posición arancelaria, volumen, valor FOB/CIF y origen) efectuadas al amparo de los regímenes que se listan en el Anexo de dicha Decisión, correspondientes al año anterior.

Que para ello, se instruyó al CT N° 2 a presentar una propuesta que permita la obtención de dicha información a través de la carga de los datos correspondientes a dichas importaciones, en los sistemas informáticos aduaneros de cada Estado Parte.

Que el CT N° 2 elaboró una clasificación de los regímenes en cuestión, distinguiendo tres grupos según la mayor o menor posibilidad de obtener la información comercial indicada en la Decisión CMC N° 03/06, de acuerdo al grado de informatización actualmente existente y a la naturaleza de cada régimen especial.

Que en virtud de dicha clasificación, resulta necesario establecer un criterio para el cumplimiento de la instrucción contenida en el artículo 6° de la Decisión CMC N° 03/06.

LA COMISIÓN DE COMERCIO DEL MERCOSUR APRUEBA LA SIGUIENTE DIRECTIVA:

Art. 1.- Adóptase para los Regímenes Especiales de Importación comprendidos en el Anexo de la Decisión CMC N° 03/06, incluyendo los incorporados por las Directivas CCM N° 12/06 y 31/09, la clasificación que consta en Anexo y forma parte de la presente Directiva.

Art. 2 - Los Estados Partes que a la fecha de entrada en vigencia de la presente Directiva no tengan informatizados los regímenes clasificados dentro de los Subgrupos B y C del Anexo, quedarán exceptuados de la exigencia del Artículo 6° de la Decisión CMC N° 03/06. En el caso de los regímenes clasificados como B se podrán presentar aquellos datos que resulten viables y se encuentren disponibles a través de los sistemas aduaneros actualmente vigentes.

Art. 3 - En la medida de los avances que pudieran ocurrir en la

informatización de los regímenes citados precedentemente, los Estados Partes deberán informarlos en la última Reunión Anual Ordinaria de la CCM de cada año.

Art. 4.- Los Estados Partes deberán instruir a sus respectivas Representaciones ante la Asociación Latino-americana de Integración (ALADI) a protocolizar la presente Directiva en el ámbito del Acuerdo de Complementación Económica N° 18, en los términos establecidos en la Resolución GMC N° 43/03.

Art. 5.- Esta Directiva deberá ser incorporada al ordenamiento jurídico de los Estados Partes antes del 01/VIII/11.

CXVIII CCM – Montevideo, 03/III/11.

ANEXO

Clasificación de los Regímenes Especiales de Importación incluidos en el Anexo de la Decisión CMC N° 03/06, incluyendo los incorporados por las Directivas CCM N° 12/06 y 31/09

- * Subgrupo A: Regímenes que se encuentran informatizados y respecto de los cuales es posible brindar la información referida en el art. 6 de la Dec. CMC N° 03/06.
- * Subgrupo B: Regímenes que se encuentran informatizados, pero por su naturaleza no comercial, no permiten obtener la totalidad de los datos solicitados
- * Subgrupo C: Regímenes que no se encuentran informatizados en la actualidad y respecto de los cuales al no estar registrados a través de sistemas informáticos es complejo recabar cualquier tipo de datos.

REGIMENES ESPECIALES	SUB GRUPO		
	A	B	C
Argentina			
Régimen de envío de asistencia y salvamento Arts. 581 a 584 (CAA)		X	
Régimen de franquicias diplomáticas Arts. 529 a 549 (CAA)		X	
Medios de transporte de guerra, seguridad y policía Arts. 472 a 484 (CAA)		X	
Envíos de mercadería con deficiencias Arts. 573 a 577 (CAA)	X		
Régimen de envíos postales Arts. 550 a 559 (CAA)		X	X
Régimen de muestras Arts. 560 a 565 (CAA)	X		
Despacho de Oficio - Arts.429 a 436 (CAA)		X	
Régimen de tráfico fronterizo Arts. 578 a 580 (CAA)		X	
Obras de arte hechas a mano - Art. 4 de la Ley 24.633	X	X	
Mercaderías importadas en el marco de los acuerdos internacionales de Cooperación Técnica.		X	
Exención de (Derechos de Importación) para los Clubes - Ley N° 16.774 (derogado por Ley N° 20.545 desgravación por derechos de importación)	X		
Partidos Políticos – Ley N° 25.600 (derogada por Ley N° 26.215)		X	
Exención de derechos de importación a ferias y misiones comerciales.- Ley N° 20.545 (derogada por Ley N° 22.792)		X	
Bienes- enseñanza, investigación y salubridad. Decreto N° 732/72		X	

Reimportación de mercadería exportada para consumo. Arts. 566 a 572. Decreto 1001/82.	X		
Automotores para personas con discapacidad.		X	
Ley N° 24.805, referente a la construcción de acueductos en la Provincia de La Pampa	X		
Régimen de importación destinado a la rehabilitación, al tratamiento y la capacitación de las personas con discapacidad, establecido por la Resolución del ex Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos N° 1388/97, y su modificatoria		X	
Brasil	A	B	C
Régimen de envío de asistencia y salvamento		X	
Mercadería extranjera idéntica, en igual cantidad y valor, y que se destine a la reposición de otra anteriormente importada que haya resultado, con posterioridad al despacho aduanero, defectuosa o inservible para el fin al cual se destinaba.		X	
Envíos postales y encomienda aéreas internacionales, destinadas a personas físicas.			X
Mercadería extranjera que haya sido objeto de decomiso, excepto en caso de no haber sido localizada, haya sido consumida o revendida. (Ley N° 10.833/03 art. 77 y reglamento aduanero art. 73, inc III).		X	
Bienes traídos del exterior, en el marco del comercio característico de ciudades situadas en las fronteras terrestres (con terceros países exclusivamente)			X
Objetos de arte recibidos en donación, por museos (a importarse por entidades públicas autorizadas)		X	
Bienes importados al amparo de Acuerdos Internacionales de cooperación técnica, con tratamiento tributario previstos en los mismos.	X		
Partidos políticos e instituciones de educación o de asistencia social	X		
Mercaderías destinadas al consumo en el recinto de congresos, de ferias, exposiciones internacionales y de otros eventos internacionales similares			X
Libros, Diarios, Periódicos y el papel destinado a su impresión	X	X	X
Unión, Estados, Distrito Federal, Territorios, Municipios y sus respectivos entes autónomos y fundaciones	X		
Bienes destinados a fabricar urnas electrónicas de votos	X		
Equipos y material destinado, exclusivamente, al entrenamiento de atletas y a las competiciones deportivas relacionados con la preparación de los equipos brasileños para juegos olímpicos, paraolímpicos, panamericanos, parapanamericanos y mundiales	X		
Mercadería nacional o nacionalizada exportada que retorne al País: a) enviadas en consignación y no vendidas en los plazos autorizados; b) devuelta por motivo de defecto técnico, para reparación o para sustitución; c) por motivo de modificaciones en la sistemática de importación por parte del país importador; d) por motivo de guerra o de calamidad pública y e) por otros factores ajenos a la voluntad del exportador	X		

Muestras y envíos postales internacionales, sin valor comercial (Ley no 8.032, de 1990, art. 2°, inciso II, literal "b", y Ley n° 8.402, de 1992, art. 1°, inciso IV; artículo 15, DL N° 37/66)			X
Embarcaciones construidas en Brasil y transferidas por matriz de empresa brasileña de navegación para subsidiaria integral en el exterior, que retornen al registro brasileño, como propiedad de la misma empresa nacional de origen (Ley n° 9.432, del 8 de enero de 1997, art. 11, § 10)	X		
Misiones Diplomáticas, Reparticiones Consulares y representaciones de organismos internacionales, de carácter permanente, incluso los de ámbito regional, de los que Brasil sea miembro, y a los bienes de sus integrantes, incluidos los automotores (Ley no 8.032, de 1990, art. 2°, inciso I, literal "c", y Ley n° 8.402, de 1992, art. 1°, inciso IV y art. 140 del R. A. de Franquicias Diplomáticas)			X
Paraguay	A	B	C
Tráfico Fronterizo. Sección 8. Art. 234, 235 y 236. Código Aduanero. Ley N° 2.422/04 (con terceros países exclusivamente)			X
Acuerdo de alcance parcial de cooperación y intercambio de bienes en las áreas cultural educacional y científica. Ley N° 367/94			X
Exoneración de Tributos a la Importación y Comercialización de libros, periódicos y revistas. Modifícase y ampliase la Ley N° 22 del 6 de Agosto de 1992. Ley N° 94/92	X		
Reembarque. Artículo 93 Ley 2422/04			X
Exención de Pago del Tributo por destrucción Total o Pérdida de Mercaderías. Art. N° 267. Código Aduanero. Ley N° 2.422/04			X
Exonera el pago de tributos las donaciones otorgadas a favor del Estado y Otras Instituciones y modifica el Art. 184 de la Ley N° 1.173/5. Ley N° 302/93. Decreto N° 6.359/05		X	
Ley N° 1095/84 art. 8 inmigrantes repatriados			X

3

Decreto 503/011

Apruébase el Octogésimo Séptimo Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica N° 18, que incorpora la Decisión N° 59/10 del Consejo del Mercado Común, relativa a "Regímenes Nacionales Especiales de Importación no contemplados en las Secciones VI y VII de la Decisión CMC N° 56/10".

(136*R)

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA
 MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA

Montevideo, 30 de Diciembre de 2011

VISTO: el Octogésimo Séptimo Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica N° 18, suscrito el 28 de setiembre de 2011 entre los Gobiernos de la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, Estados Partes del MERCOSUR, al amparo de las disposiciones establecidas en el Tratado de Montevideo de 1980;

RESULTANDO: I) que en el mismo se incorpora al Acuerdo de Complementación Económica N° 18, la Decisión N° 59/10 relativa a "Regímenes Nacionales Especiales de Importación no contemplados en las Secciones VI y VII de la Decisión CMC N° 56/10", aprobada por el Consejo del Mercado Común, el 16 de diciembre de 2010;

II) que la Decisión CMC N° 59/10 tiene por objeto elevar a través del Grupo Mercado Común, una propuesta de tratamiento de otros regímenes nacionales especiales de importación no contemplados en las Secciones VI y VII de la Decisión CMC N° 56/10 "Programa de Consolidación de la Unión Aduanera", a más tardar en la última Reunión Ordinaria de 2013;

III) que esta propuesta deberá contemplar un tratamiento a otorgar a los regímenes especiales de importación adoptados unilateralmente por los Estados Partes, que impliquen la exención total o parcial de los derechos aduaneros (Arancel Externo Común) que gravan la importación definitiva de mercaderías cuyo objetivo no sea el perfeccionamiento para posterior exportación de las mercaderías resultantes hacia terceros países, así como los beneficios concedidos al amparo de tales regímenes;

IV) que la citada protocolización fue realizada conforme a lo previsto en el artículo 8 de la Decisión CMC N° 59/10;

CONSIDERANDO: I) que de acuerdo a lo previsto en el artículo 2 del mencionado Protocolo, éste entrará en vigor 30 días después de la notificación de la Secretaría General de la ALADI a los países signatarios de que recibió la comunicación de la Secretaría del MERCOSUR, informando la incorporación de la norma MERCOSUR y de su correspondiente Protocolo Adicional a los ordenamientos jurídicos de los cuatro Estados Partes del MERCOSUR;

II) que a los efectos referidos precedentemente, corresponde incorporar al ordenamiento jurídico interno, el Octogésimo Séptimo Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica N° 18;

ATENTO: a lo informado por la Delegación Permanente de la República Oriental del Uruguay ante ALADI y MERCOSUR.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- Apruébase el Octogésimo Séptimo Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica N° 18, suscrito el 28 de setiembre de 2011 entre los Gobiernos de la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, Estados Partes del MERCOSUR, que consta como anexo y forma parte del presente Decreto, y por el cual se incorpora al Acuerdo de Complementación Económica N° 18, al amparo de las disposiciones establecidas en el Tratado de Montevideo de 1980, la Decisión N° 59/10 del Consejo del Mercado Común relativa "Regímenes Nacionales Especiales de Importación no contemplados en las Secciones VI y VII de la Decisión CMC N° 56/10".

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese y dése cuenta a la Asamblea General.

JOSÉ MUJICA, Presidente de la República; ROBERTO CONDE; FERNANDO LORENZO; EDGARDO ORTUÑO; TABARÉ AGUERRE.

ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN ECONÓMICA N° 18 CELEBRADO ENTRE ARGENTINA, BRASIL, PARAGUAY Y URUGUAY

Octogésimo Séptimo Protocolo Adicional

Los Plenipotenciarios de la República Argentina, de la República Federativa del Brasil, de la República del Paraguay y de la República Oriental del Uruguay, acreditados por sus respectivos Gobiernos, según poderes otorgados en buena y debida forma,

depositados oportunamente en la Secretaría General de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI),

TENIENDO EN CUENTA el Décimo Octavo Protocolo Adicional al ACE 18 y la Resolución GMC N° 43/03,

CONVIENEN:

Artículo 1º - Incorporar al Acuerdo de Complementación Económica N° 18 la Decisión N° 59/10 del Consejo del Mercado Común relativa a "Regímenes Nacionales Especiales de Importación no contemplados en las Secciones VI y VII de la Decisión CMC N° 56/10", que consta como Anexo e integra el presente Protocolo.

Artículo 2º - El presente Protocolo entrará en vigor 30 días después de la notificación de la Secretaría General de la ALADI a los países signatarios de que recibió la comunicación de la Secretaría del MERCOSUR, informando la incorporación de la norma MERCOSUR y de su correspondiente Protocolo Adicional a los ordenamientos jurídicos de los cuatro Estados Partes del MERCOSUR.

La Secretaría General de la ALADI deberá efectuar dicha notificación, en lo posible, el mismo día de recibida la comunicación de la Secretaría del MERCOSUR.

La Secretaría General de la ALADI será depositaria del presente Protocolo, del cual enviará copias debidamente autenticadas a los Gobiernos de los países signatarios y a la Secretaría del MERCOSUR.

EN FÉ DE LO CUAL, los respectivos Plenipotenciarios firman el presente Protocolo en la ciudad de Montevideo, a los veintiocho días del mes de setiembre del año dos mil once, en un original en los idiomas español y portugués, siendo ambos textos igualmente válidos.

Por el Gobierno de la República Argentina: Daniel Raimondi.
Por el Gobierno de la República Federativa del Brasil: Otávio Brandelli.

Por el Gobierno de la República del Paraguay: Alejandro Hamed Franco.

Por el Gobierno de la República Oriental del Uruguay: Gonzalo Rodríguez Gigena.

ANEXO

MERCOSUR/CMC/DEC. N° 59/10

REGÍMENES NACIONALES ESPECIALES DE IMPORTACIÓN NO CONTEMPLADOS EN LAS SECCIONES VI y VII DE LA DECISIÓN CMC N° 56/10

VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto y las Decisiones N° 31/00, 69/00, 16/01, 32/03, 33/05, 02/06, 03/06, 14/07, 57/08 y 20/09 del Consejo del Mercado Común.

CONSIDERANDO:

Que la Decisión CMC N° 69/00 dispone que los Estados Partes podrán establecer Regímenes Especiales Comunes de Importación para el MERCOSUR, determinando, por otro lado, la eliminación de los regímenes aduaneros especiales de importación adoptados unilateralmente por los Estados Partes.

Que la Decisión CMC N° 02/06 estableció los sectores que deberán ser objeto de la elaboración de Regímenes Especiales Comunes de Importación.

Que es necesario establecer plazos adicionales a aquellos fijados en la Decisión CMC N° 57/08 para que los Estados Partes concluyan las tareas tendientes a la armonización de los regímenes especiales de importación en el MERCOSUR y eliminen los regímenes nacionales adoptados unilateralmente.

Que la Decisión CMC N° 20/09 prevé un tratamiento arancelario especial, en los casos de Paraguay y del Uruguay, para la importación

de insumos agropecuarios de extrazona, así como, en el caso de Paraguay, para la importación de materias primas.

**EL CONSEJO DEL MERCADO COMÚN
DECIDE:**

Art. 1 – El Grupo Mercado Común elevará una propuesta de tratamiento de otros regímenes nacionales especiales de importación no contemplados en las Secciones VI y VII de la Decisión CMC Nº 56/10 “Programa de Consolidación de la Unión Aduanera”, a más tardar en su última Reunión Ordinaria de 2013.

Art. 2 – La propuesta mencionada en el Artículo 1 deberá contemplar un tratamiento a otorgar a los regímenes especiales de importación adoptados unilateralmente por los Estados Partes, que impliquen la exención total o parcial de los derechos aduaneros (Arancel Externo Común) que gravan la importación definitiva de mercaderías cuyo objetivo no sea el perfeccionamiento para posterior exportación de las mercaderías resultantes hacia terceros países, así como los beneficios concedidos al amparo de tales regímenes.

Art. 3 – Los Artículos 1 y 2 no se aplican a los regímenes nacionales que podrán permanecer vigentes por razones de impacto económico limitado o finalidad no comercial, en los términos de la Decisión CMC Nº 03/06, ni tampoco a aquellos armonizados en el marco de la Decisión CMC Nº 02/06.

Art. 4 – Los Estados Partes notificarán a la Comisión de Comercio del MERCOSUR, a más tardar en el primer semestre de 2012, los regímenes especiales de importación a que se refieren los Artículos 1 y 2, exceptuados los regímenes mencionados en el Artículo 3.

4.1. Asimismo, notificarán anualmente a la Comisión de Comercio del MERCOSUR, a partir de 31 de enero de 2013, los regímenes de que trata la presente Decisión, independientemente de eventuales alteraciones introducidas en los mismos.

Art. 5 – Paraguay y Uruguay podrán aplicar, hasta 31 de diciembre de 2016, en la medida en que no utilicen regímenes de admisión temporal y “draw-back”, una alícuota del 2% para la importación de insumos agropecuarios, de acuerdo con la lista de ítems arancelarios a ser notificados por cada Estado Parte a la Comisión de Comercio del MERCOSUR antes de 31 de diciembre de 2013.

Art. 6 – Crear, antes del 31 de diciembre de 2016, el régimen para la importación de materias primas para Paraguay, mediante el cual podrá importar insumos con una alícuota del 2%. La Comisión de Comercio del MERCOSUR elevará, antes de su última Reunión Ordinaria de 2013, una propuesta de mecanismo y las condiciones por las cuales Paraguay podrá utilizar el referido régimen.

6.1. Hasta la entrada en vigencia el régimen previsto en el presente Artículo y su reglamentación, se prorroga la vigencia de lo establecido en el Artículo 1 de la Decisión CMC Nº 32/03. Dicha prórroga no se extenderá más allá del 31 de diciembre de 2016.

Art. 7 – Paraguay y Uruguay notificarán los datos estadísticos correspondientes a la utilización de los regímenes mencionados en los Artículos 5 y 6 de acuerdo con las especificaciones y la frecuencia que determine la Comisión de Comercio del MERCOSUR, a más tardar antes de su tercera Reunión Ordinaria del primer semestre de 2011.

Art. 8 - Solicitar a los Estados Partes que instruyan a sus respectivas Representaciones ante la Asociación Latino Americana de Integración (ALADI) a protocolizar la presente Decisión en el ámbito del Acuerdo de Complementación Económica Nº 18, en los términos establecidos en la Resolución GMC Nº 43/03.

Art. 9 - Esta Decisión deberá ser incorporada al ordenamiento jurídico de los Estados Partes antes del 30/VI/2011.

XL CMC – Foz de Iguazú, 16/XII/10

CD's

- CÓDIGO CIVIL (Incluye Apéndice Normativo).....	\$ 150
- CONSTITUCIÓN NACIONAL (Con enmiendas Plebiscitos 1989, 1994, 1996 y 2004).....	\$ 275
- NORMAS ARANCELARIAS DEL MERCOSUR	
(Arancel Externo Común, Decreto 642/006, Lista de Excepciones, Nomenclaturas Arancelarias y otras relacionadas. Contiene índice temático y cronológico)	
	\$ 150
- PRESUPUESTO NACIONAL (Ley Nº 17.930).....	\$ 140
- NUEVO SISTEMA TRIBUTARIO	\$ 140
- DECRETO 500/991 (Actualizado Marzo 2011).....	\$ 150
- REGLAMENTO BROMATOLÓGICO NACIONAL (Incluye Apéndice Normativo)	\$ 150
- TOCAF 1996 - TEXTO ORDENADO DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	
(Incluye Apéndice Normativo).....	
	\$ 140
- CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO (Incluye Apéndice Normativo).....	\$ 150
- CÓDIGO DE COMERCIO (Incluye Apéndice Normativo)	\$ 150
- CÓDIGO PENAL (Incluye Apéndice Normativo).....	\$ 150
- CÓDIGO TRIBUTARIO (Incluye Apéndice Normativo).....	\$ 150
- CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA (Incluye Apéndice Normativo)	\$ 150
- REGISTRO NACIONAL DE LEYES Y DECRETOS	\$ 150
- INVESTIGACIÓN HISTÓRICA SOBRE DETENIDOS DESAPARECIDOS	\$ 150